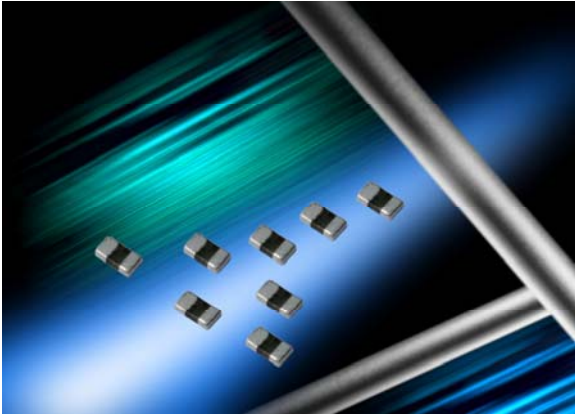




High Temperature Automotive MultiLayer Varistor



AVX High Temperature Multi-Layer Varistors are designed for underhood applications. Products have been tested, qualified, and specified to 150°C. The MLV advantage is EMI/RFI attenuation in the off state. This allows designers the ability to combine the circuit protection and EMI/RFI attenuation function into a single highly reliable device.

The CAN and AntennaGuard series are the first releases in a planned series to include higher voltages and a variety of case size. AEC Q200 data packages available.

AVX Part No.	V _W (DC)	V _W (AC)	V _B	I _L	E _T	I _P	Cap.	Case Size	Elements
CANAT01_ _	≤ 18	≤14	120	10	0.015	4	22	0603	1
CANAT02_ _	≤ 18	≤14	70	10	0.015	4	22	0405	2
CANAT04_ _	≤ 18	≤14	100	10	0.015	4	22	0612	4

AVX Part NO.	V _W (DC)	V _W (AC)	I _L	Cap	Cap Tolerance	Case Size
VCAT06AG18120YAT_ _	≤ 18	≤ 14	10	12	+4, -2pF	0603

V_W(DC) DC Working Voltage [V]

V_W(AC) AC Working Voltage [V]

V_B Breakdown Voltage [V @ 1mA_{DC}]

V_C Clamping Voltage [V @ I_{VC}]

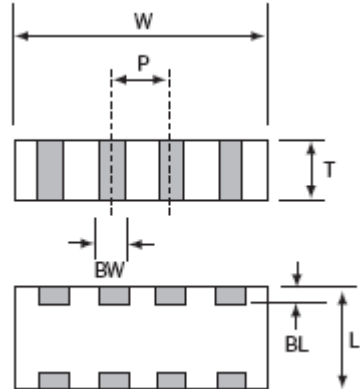
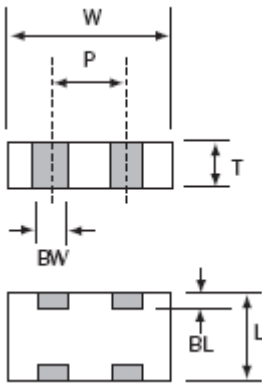
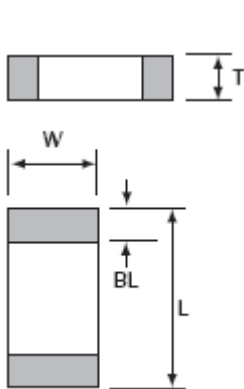
I_{VC} Test Current for V_C [A, 8x20μS]

I_L Maximum leakage current at the working voltage [μA]

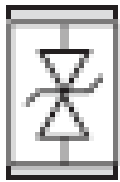
E_T Transient Energy Rating [J, 10x1000μS]

I_P Peak Current Rating [A, 8x20μS]

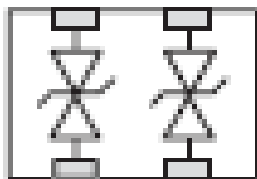
Cap Capacitance [pF] @ 1KHz specified and 0.5V_{RMS}



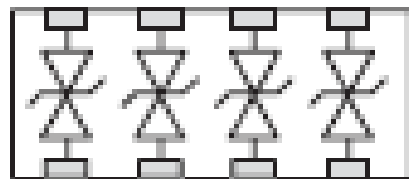
Size (EIA)	0603 Discrete	0405 - 2 Elements Array	0612 - 4 Elements Array
L	1.60±.15 (0.063±0.006)	1.00±0.15 (0.039±0.006)	1.60±0.20 (0.063±0.008)
W	0.80±0.15 (0.032±0.006)	1.37±0.15 (0.054±0.006)	3.20±0.20 (0.126±0.008)
T	0.90 Max (0.035 Max.)	0.66 Max (0.026 Max.)	1.22 Max (0.048 Max.)
BW	N/A	0.36±0.10 (0.014±0.004)	0.41±0.10 (0.016±0.004)
BL	0.35±0.15 (0.014±0.006)	0.20±0.10 (0.008±0.004)	0.18+0.25/-0.08 (0.007+0.01/-0.003)
P	N/A	0.64 REF (0.025 REF)	0.76 REF (0.030 REF)



**0603
Discrete**



**0405
Array**



**0612
Array**

No.	Item	Requirement	Test method
1	Operating Temp.	-55°C to +150° C	
2	Appearance/Dimensions	No visible damage Dimensions: see par. 6	Visual examination at 10% magnification Dimensions verification by class2 caliper
3	Peak Current	Breakdown voltage change shall not be more than $\pm 10\%$	a. Apply 1mA DC of each polarity to device terminals. Record polarity and magnitude of resultant voltage. b. Apply 8x20 μ S current pulse, peak value per standard parts table 5, to terminals with same polarity as Step (a). c. Apply 1mA DC to terminals, same polarity as Steps (a) and (b). Record magnitude of resultant voltage.
4	Transient Energy	Breakdown voltage change shall not be more than $\pm 10\%$	(a) Apply 1mA DC of each polarity to device terminals. Record polarity and magnitude of resultant voltage. (b) Apply 10x1000 μ S current pulse of amplitude sufficient to generate the energy as specified in standard parts table, 5(calculated by $E=0.0014V_p I_p$, where V_p is peak value of voltage and I_p is peak current)
5	Solderability	The dipped surface shall be at least 95% covered with a new smooth solder coating.	Soak in eutectic solder bath of temperature at 230+/-5°C for 5sec.
6	Solder heat resistance	No mechanical damage. Forward Breakdown voltage change shall not be more than $\pm 10\%$	a. Read forward breakdown voltage. b. Soak in eutectic solder bath of temperature at 260+/-5°C. for 10+/-1sec. c. Natural cool down to +25°C d. Read forward breakdown voltage after 24+/-2 hours.
7	Humidity Life	Forward breakdown voltage change shall not be more than $\pm 10\%$	a. Read forward breakdown voltage. b. Leave device in chamber of +85+/-3°C, 85+5% relative humidity at 100% of working voltage for 1,000 \pm 5hours. c. Read forward breakdown voltage after 3-4 hours conditioning at 25+/-5°C
8	Life Test	Forward breakdown voltage change shall not be more than $\pm 10\%$ and IL spec is allowed to increase by one order of magnitude	a. Read forward breakdown voltage. b. Apply 100% of working voltage at test temperature of 150+/-4°C for 1,000+48/-0hours. c. Read forward breakdown voltage after 24+/-2 hours conditioning at 25+/-5°C
9	Termination Strength	All components must stay in place.	a. Solder components onto substrate. b. Apply 500 grams lateral force across the body of the component.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.